

证券代码：002384

证券简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-09-16

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>                                    |
| 参与单位名称及人员姓名   | 国盛证券、新华资产、华安、富国、交银、广发、诺德、国投瑞银、太平资产、平安养老等 176 位机构投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2025 年 9 月 16 日下午 14:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点            | 江苏常州中德（常州）创新产业园 1 号楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长 袁永刚<br>董事、董事会秘书 冒小燕<br>投关总监 熊丹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1. 公司 AI 的战略布局具体是什么？<br/>答：公司 AI 战略布局，核心是围绕 AI 产业生态的硬件基础设施需求构建竞争力。 目前公司在消费电子和新能源汽车方面已经覆盖国际领先头部客户，基本盘业务稳中求进，未来重点推进适配高增长、高性能场景下 AI 算力所需高端 PCB 和光模块的研发和生产，围绕这两大产品加大资本性开支，提升产能建设及规模化交付能力，夯实自身在 AI 硬件供应链中的核心竞争地位。</div> <div>2. 公司 AI PCB 技术优势？<br/>答：公司 AI PCB 业务发展的基础是源于 Multek 深厚的技术积淀与资源储备。Multek 原为伟创力旗下企业，技术能力显著，服务于国际知名客户，在高端 PCB 领域积累了成熟的技术体系；其拥有的优质客户资源，省去了从零搭建客户网络的时间。技术</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>维度上，Multek 也是行业内少数能同时掌握 HDI（高密度互联）、高多层 PCB 等核心技术的企业，早期凭借高多层 PCB 在通讯设备中的规模化应用，积累了扎实的制造工艺经验，后续通过技术融合进一步形成多阶 HDI 产品能力，能精准适配 AI 设备对“高密度+多层级”产品的核心需求，更具备匹配 AI 高算力场景的技术实力，可充分满足高端 AI 应用的性能要求。</p> <p>3. 公司 AI PCB 产能扩建是否遇到设备问题以及未来展望？</p> <p>答：为保障 AI PCB 业务产能及时释放，公司提前实施了设备与供应链保障策略，锁定镭射钻孔等核心生产环节的产能设备资源，为业务产能规模化释放提供坚实硬件支撑。随着 AI 算力需求持续增长，PCB 产品层数将进一步提升，产品单价也会随之上涨，我们认为未来行业需求与产品价值均呈上升趋势。公司凭借 Multek 技术壁垒与提前布局产能优势，在市场竞争中占据有利地位，后续有望依托技术与产能双重支撑，实现业务的扩张。</p> <p>4. 索尔思收购进展如何？</p> <p>答：目前收购进展顺利，核心交易环节已按计划推进。</p> <p>5. 当前光芯片市场紧缺情况如何？扩产周期有何差异？</p> <p>答：当前光芯片市场因 AI 驱动的高速光模块需求爆发而呈现显著紧缺态势，尤其是 800G 及以上高速率产品的供应缺口尤为突出，供应紧张格局短期难以缓解。从扩产周期来看，光芯片与光模块存在明显差异，光芯片扩产需 1 年左右的产能建设周期，且需通过长达 3 年的客户验证；而光模块扩产更为灵活，扩产节奏能快速响应客户需求变化。这种周期差异使得光芯片紧缺缓解速度远慢于光模块，具备技术积累和客户验证优势的供应商将在当前格局中占据更有利地位。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>6. 索尔思芯片的扩产计划和良率情况如何？</p> <p>答：在光芯片领域，我们认为索尔思的核心竞争力是自研能力，收购后的扩产计划将聚焦高端光模块（800G、1.6T 等）的需求，推进技术迭代与产能优化。索尔思股权交割后，依托战略协同，公司将会加大对索尔思的资本与供应链支持，通过 IDM 垂直整合模式保障产能稳定与成本可控，同时推进高端芯片研发量产，及时响应 AI 服务器或数据中心客户需求。</p> <p>7. 目前索尔思在大客户拓展上有哪些进展？</p> <p>答：索尔思在大客户上核心围绕高端光模块产品的市场渗透，收购后长期目标将重点锁定 2027 年全球顶级科技客户的 1.6T 光模块需求，同时优化生产基地为 2026 年业务放量夯实产能基础。</p> <p>8. 索尔思在 800G/1.6T/3.2T 光模块及硅光技术上有哪些储备和规划？</p> <p>答：索尔思在光模块技术布局上采取 EML 与硅光方案双轨并行策略。当前以 EML 方案为主力推进 800G/1.6T 产品送样，同时重点培育硅光技术——其硅光方案成本优势显著，在 LRO、DSP 减半及 LPO 等场景中具备应用优先级。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期       | 2025-09-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |